

Presseinformation

Weltneuheit

29TC11
April 2011

TELSONIC präsentiert neues Impulssiegelverfahren auf der Interpack

Das Beste aus zwei Welten

Das neue Impulssiegelverfahren der Telsonic AG vereint Ultraschallschweißen mit dem thermischen Siegeln in einem Vorgang.

(Bronschhofen) Eine Weltneuheit präsentiert die Schweizer TELSONIC AG auf der Interpack. Das neue Impulssiegelverfahren bringt die Vorteile zweier Siegelverfahren zusammen. Erstmals ist es gelungen das thermische Siegeln und das Ultraschallschweißen in einer Siegeleinheit zu vereinen. Damit lassen sich mehrlagige Siegelränder genauso wie dünne Folien sicher verschließen. Der Schweißprozess wird deutlich flexibler.

„Es ist uns zusammen mit unserem Partner Ropex gelungen sowohl die Vorteile des thermischen Siegelns als auch des Ultraschallschweißens deutlich zu stärken und die Nachteile beider Verfahren zu eliminieren“, betont Hartmut Möglich, verantwortlich für den Packagingbereich bei der Telsonic AG. Die Ultraschallxperten haben in einer Siegelstation beide Verfahren zusammengeführt. Beim Prozess bereitet das thermische Siegeln die Folien durch ein Anheizen vor. Dies verbessert die Fließeigenschaften des Materials. Eingesetzt wird hierfür die Impulssiegeltechnologie Cirus der Ropex GmbH. Auf einer vertikalen Schlauchbeutelmaschine wird somit gerade auch bei mehreren Lagen an der Längsnaht ein sicherer Siegelprozess vorbereitet. Das Ultraschallschweißen sorgt dann für eine sichere Randsiegelnaht, weil es auch in produktbenetzten Zonen zuverlässig versiegelt.

Weniger Hitze und geringere Amplitude schont

Indem der thermische Prozess mit weniger Wärme auskommt und beim Ultraschallschweißen die Amplitude zurückgefahren werden kann, konnten die prinzipbedingten Nachteile beider Prozesse ausgeschaltet werden. So werden Lebensmittel nicht mehr unnötig erwärmt und dünne Folien nicht mehr beschädigt. Dennoch bleibt die Reinigungskraft des Ultraschalls bestehen und durch das thermische Verfahren werden auch mehrere Lagen sicher verschlossen. In der Siegelzone gibt es keine

Kontakt und Information:

TELSONIC AG
Industriestrasse 6b
CH-9552 Bronschhofen
Tel +41 71 913 98 88
Fax +41 71 913 98 77
hartmut.moeglich@telsonic.com
www.telsonic.com

Fehlstellen durch kontaminierte Flächen, sondern einen sauberen Schweißverbund. Der Schweißprozess selbst wird durch den Einsatz beider Verfahren nun deutlich flexibler. „Anwender können sich auch an bisher schwierige Verschlussituationen wagen“, versichert Möglich. So kann das Impulssiegeln beispielsweise auch zeitlich genauer definiert werden.

Die Idee zum neuen Impulsschweißverfahren schildert Möglich wie folgt: „Beide Verfahren, das thermische Impulssiegeln und das Ultraschallschweißen, haben ihre prinzipbedingten Nachteile, die sie für bestimmte Anwendungen disqualifizieren. Also haben wir uns bei Telsonic über die Kombination Gedanken gemacht. Herausgekommen ist das Impulssiegeln, das wir zusammen mit Ropex entwickelt haben und auf den Markt bringen.“

Pionier und Technologieführer aus der Schweiz

Die Schweizer Telsonic AG ist Pionier in der Ultraschalltechnologie. Das 1966 gegründete Unternehmen mit Tochterfirmen in Deutschland, England, Südosteuropa, China und den USA sowie einem Joint Venture in Indien und Vertretungen in vielen Ländern besitzt zahlreiche Patente und setzt die Ultraschalltechnologie zum Schweißen, Trennschweißen, Reinigen und Sieben sowie in chemischen Prozessen und im Packaging ein.

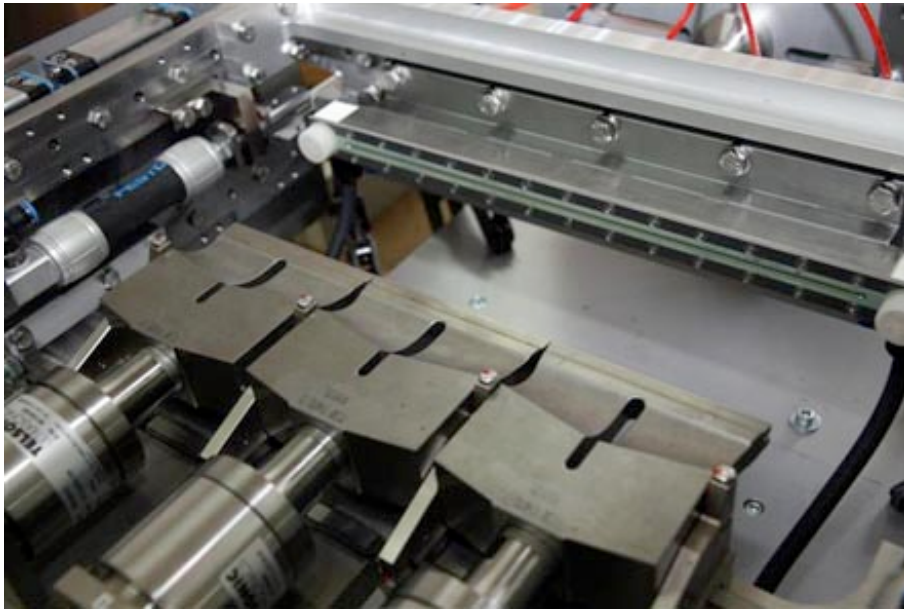


Bild Nr. 29-01 TC_Impulssiegeln.jpg.

Das neue Impulssiegeln, das die Telsonic.AG zusammen mit Ropex entwickelt hat, vereint die Vorteile des Thermosiegeln und des Ultraschallschweißens.